

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED

華虹半導體有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1347)

有關晶圓代工服務協議的持續關連交易

晶圓代工服務協議

董事會宣佈，於二零一九年九月二十七日，本公司非全資子公司華虹無錫與上海華力訂立晶圓代工服務協議，據此，上海華力已同意向華虹無錫提供晶圓代工服務。

上市規則的涵義

於本公告日期，上海華力由本公司控股股東上海聯和擁有50.23%權益。因此，上海華力為本公司關連人士，而晶圓代工服務協議項下擬進行交易根據上市規則第十四A章構成本公司的持續關連交易。

由於技術開發協議及晶圓代工服務協議均由本集團與上海華力訂立，而該等協議屬類似性質，技術開發協議項下進行的交易及晶圓代工服務協議項下進行的交易將根據上市規則第14A.82(1)條及第14A.83條合併計算及處理，猶如本集團與上海華力之同一交易。因此，截至二零一九年十二月三十一日止年度技術開發協議項下進行交易及晶圓代工服務協議年度上限的付款於計算上市規則第十四A章項下相關百分比率時將合併計算。

由於上市規則第14.07條所載有關技術開發協議項下付款及晶圓代工服務協議年度上限按合併基準計算的各個適用百分比率均高於0.1%但低於5%，晶圓代工服務協議項下擬進行的交易僅須遵守上市規則第十四A章的申報、年度審核及公告規定，但獲豁免遵守通函及獨立股東批准的規定。

概無董事於以上交易中擁有重大權益或須於董事會會議上放棄投票。

背景

於二零一九年九月二十七日，本公司非全資子公司華虹無錫與上海華力訂立晶圓代工服務協議，據此，上海華力已同意向華虹無錫提供晶圓代工服務。

晶圓代工服務協議

晶圓代工服務協議主要條款概要

晶圓代工服務協議主要條款概要載列如下：

- 日期：二零一九年九月二十七日
- 訂約方：(i) 華虹無錫；及
(ii) 上海華力
- 期限：自二零一九年九月二十七日至二零二二年九月二十六日（包括首尾兩日）為期三（3）年，任何訂約方均可於期限屆滿前至少30日透過書面通知予以終止協議
- 提供之服務：上海華力已同意提供晶圓代工服務，有關服務包括：
- (i) 向華虹無錫提供與晶圓的生產工藝有關的服務及協助（「**工藝服務**」）；及
 - (ii) 製造及供應12英寸（300mm）晶圓以測試華虹無錫的生產線及提供部份工藝支持（「**工程晶圓服務**」）。
- 付款安排：就工藝服務而言，華虹無錫應以人民幣向上海華力付款。華虹無錫所作各項訂單的付款安排如下：
- (i) 上海華力應發出報價，載列華虹無錫要求的工藝技術規範、晶圓的單價、交付方式及付款期限。

- (ii) 華虹無錫應將上海華力的報價納入華虹無錫向華虹無錫的最終客戶發出的統一報價，供彼等確認，
- (iii) 協定報價所列條款後，華虹無錫應向上海華力下達正式採購訂單。
- (iv) 華虹無錫應按報價所規定的時間向上海華力支付全款。

就工程晶圓服務而言，

- (i) 上海華力須發出一份載有華虹無錫所要求工藝技術規範、晶圓單價、交付方式及支付條款的報價單。
- (ii) 協定報價單所述的條款後，華虹無錫向上海華力下達正式的採購訂單。
- (iii) 華虹無錫按報價單所規定的時間向上海華力支付全款。

定價基準

：晶圓代工服務協議項下各項採購訂單涉及的購買價格應由訂約雙方經公平磋商釐定及協定：

- (i) 就工藝服務而言，參考工業晶圓及光敏層單價（預期為市價）。此外，上海華力的報價亦會納入華虹無錫的統一報價單（將由華虹無錫的最終客戶確認）。
- (ii) 就工程晶圓服務而言，經公平商業磋商並考慮到本集團與上海華力的長期合作關係。

訂立代工服務協議之理由及裨益

華虹無錫設施的建設現正接近最後階段。同時，華虹無錫已開始採用在技術開發協議下自上海華力導入的工藝技術，而根據技術開發協議，關鍵工藝的驗證亦已在上海華力的協助下完成。

目前，華虹無錫需要12英寸(300mm)晶圓以供測試其生產線及提供部份工藝支持。待華虹無錫敲定生產體系的同時，其亦需進一步協助以完成晶圓的生產，以及時滿足對55nm工藝(FAB-7工藝)的強勁市場需求。為此，華虹無錫方與上海華力訂立晶圓代工服務協議。

華虹無錫相信，晶圓代工服務協議可有助其及時交付產品。此外，華虹無錫認為上海華力具備必要專業資質及豐富經驗以確保集成電路的大規模生產能順利開展。

經審查晶圓代工服務協議的條款，董事(包括獨立非執行董事)認為：

- (a) 晶圓代工服務協議的條款屬公平合理；
- (b) 晶圓代工服務協議乃按一般商業條款或更佳條款且於本集團一般及日常業務過程中訂立；及
- (c) 訂立晶圓代工服務協議符合本公司及其股東的整體利益。

年度上限

晶圓代工服務協議項下交易的建議年度上限

下表載列截至二零二零年十二月三十一日止兩個年度代工服務協議項下交易的年度上限。

	截至二零一九年 十二月三十一日 止年度 (千美元)	截至二零二零年 十二月三十一日 止年度 (千美元)
年度上限	9,000	5,000

目前，華虹無錫預計二零二零年十二月三十一日後將不再繼續使用上海華力提供的晶圓代工服務，為防華虹無錫無法在二零二零年前完成其建設，故訂約雙方已約定一個三年的期限。因此，本公司僅就二零一九年及二零二零年設定了年度上限。

倘於二零二零年後本公司需要上海華力提供晶圓代工服務，則本公司將按照上市規則適時另行刊發公告。

建議年度上限的釐定基準

建議年度上限乃經參考預期需求及市場單價而釐定。

此外，由於華虹無錫正在敲定生產體系，華虹無錫預期能夠於二零二零年年底前完成所有生產工藝並為其本身進行測試及提供部份工藝支持。因此，預期上海華力對晶圓代工服務的預期需求會逐漸減少並於二零二零年終止。因此，二零二零年的年度上限反映有關較低需求，且年度上限低於二零一九年的年度上限。

上市規則的涵義

於本公告日期，上海華力由本公司控股股東上海聯和擁有50.23%權益。因此，上海華力為本公司關連人士，而晶圓代工服務協議項下擬進行交易根據上市規則第十四A章構成本公司的持續關連交易。

由於技術開發協議及晶圓代工服務協議均由本集團與上海華力訂立，而該等協議屬類似性質，技術開發協議項下進行的交易及晶圓代工服務協議項下進行的交易將根據上市規則第14A.82(1)條及第14A.83條合併計算及處理，猶如本集團與上海華力之同一交易。因此，截至二零一九年十二月三十一日止年度技術開發協議項下進行交易及晶圓代工服務協議年度上限的付款於計算上市規則第十四A章項下相關百分比率時將合併計算。

由於上市規則第14.07條所載有關技術開發協議項下付款及晶圓代工服務協議年度上限按合併基準計算的各個適用百分比率均高於0.1%但低於5%，晶圓代工服務協議項下擬進行的交易僅須遵守上市規則第十四A章的申報、年度審核及公告規定，但獲豁免遵守通函及獨立股東批准的規定。

概無董事於以上交易中擁有重大權益或須於董事會會議上放棄投票。

訂約方資料

本公司

本公司為特種應用的半導體（主要為8英寸(200mm)晶圓）製造商。本公司的技術，尤其是嵌入式非易失性存儲器(eNVM)及功率器件，主要應用於消費者電子、通訊、計算及工業以及汽車行業。

華虹無錫

華虹無錫目前為本公司之非全資子公司，主要從事12英寸(300mm)晶圓集成電路之設計、研究、製造、測試、封裝及銷售業務。

上海華力

上海華力由本公司控股股東上海聯和擁有50.23%權益。上海華力的主要業務為開發及運營12英寸(300mm)晶圓廠。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	華虹半導體有限公司，一家於二零零五年一月二十一日在香港註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「晶圓代工服務」	指	工藝服務及工程晶圓服務，其詳情於本公告「晶圓代工服務協議主要條款概要」一節說明
「晶圓代工服務協議」	指	華虹無錫及上海華力於二零一九年九月二十七日訂立之晶圓代工服務協議

「本集團」	指	本公司及其子公司
「華虹宏力」	指	上海華虹宏力半導體製造有限公司，一家於二零一三年一月二十四日在中國註冊成立的外資企業，並為本公司的全資子公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「華虹無錫」	指	華虹半導體（無錫）有限公司，一家於二零一七年十月十日在中國註冊成立之公司，並為本公司之非全資子公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國（惟僅就本公告而言不包括香港、澳門特別行政區及台灣）
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「上海聯和」	指	上海聯和投資有限公司，一家於一九九四年九月二十六日在中國註冊成立的公司，並為本公司的控股股東
「上海華力」	指	上海華力微電子有限公司，一家於二零一零年一月十八日在中國註冊成立的公司，由上海聯和擁有50.23%權益，並為本公司關連人士
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「子公司」	指	具有上市規則賦予的涵義
「技術開發協議」	指	華虹宏力及上海華力於二零一八年十一月二十三日訂立之技術開發協議，其詳情載於本公司日期為二零一八年十一月二十三日之公告

「工藝技術」	指	上海華力65nm CMOS先進技術及工藝技術及其所包含的全部知識產權，包括但不限於專利和技術秘密
「美元」	指	美元
「%」	指	百分比

承董事會命
華虹半導體有限公司
董事長兼執行董事
張素心先生

中國上海，二零一九年九月二十七日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

張素心 (董事長)

唐均君 (總裁)

非執行董事：

杜洋

森田隆之

王靖

葉峻

獨立非執行董事：

張祖同

王桂壘，太平紳士

葉龍蜚